

尊敬的客户，您好！

当今物联网设计所面临的问题是受限于仅能采用现有的技术解决方案，而这些技术解决方案并没有针对物联网市场需求进行过优化。有鉴于此，UMC与中关村芯园公司将于2017年8月8日联合举办“基于UMC工艺的设计与制造技术交流研讨会”，此次研讨会将为大家的带来基于UMC工艺的IoT技术解决方案及相关IP方案的分享与交流。借此机会，UMC与中关村芯园公司将进一步加强合作，深度推进双方的代工服务合作，共同助力中国大陆地区IC产业的发展。

中关村芯园 & UMC 诚邀您参加！

一、时间：2017年08月08日 星期二（PM 13:00-17:00）

二、地点：北京市海淀区中关村南大街1号1-1领创空间（友谊宾馆）

三、议程：

时间	会议安排
13:00-13:30	签到
13:30-13:40	中关村芯园 & UMC 领导致辞
13:40-13:50	合作签约仪式 ——中关村芯园 & UMC
13:50-14:00	中关村芯园服务资源介绍 ——中关村芯园呈献
14:00-14:30	UMC -- Your best IoT foundry partner ——UMC呈献
14:30-15:00	Advanced eNVM technology ——UMC呈献
15:00-15:20	中场休息
15:20-15:50	Advanced RF SoC technology ——UMC呈献
15:50-16:20	IoT RF IP Solution ——Gearradio呈献
16:20-16:50	Andes superscalar 32-bit CPU IP solution for IOT ——Andes呈献
16:50-17:00	抽奖环节

四、参会说明：

1. 邀请参加（不收费），请带两张本人名片签到。
2. 本次会议的抽奖环节将会有 Apple Watch、Kindle、平板电脑等重磅大礼等着您。
3. 联系人：陈超
4. 座机：010 - 82484520 转 826
5. 拟参加人员请将填写报名回执（见下表），[回复邮件至 pub@zgcicc.com](mailto:pub@zgcicc.com) 提交以下报名表。

姓名		公司	
手机		电话	
职务		Email	